

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

⑨Int. Cl.  
H 01 L 21/50

대한민국특허청 (KR)  
공개실용신안공보 (U)

제 544 호

⑬공개일자 서기 1992. 7. 27

⑩공개번호 92-13705

⑭출원일자 서기 1990. 12. 1

⑪출원번호 90-18896

심사청구 : 있음

⑯고안자 김 석 기 경기도 군포시 금정동 105블럭 2-1 뚝트 301호

⑰출원인 대우전자부품 주식회사 대표이사 김 용 원

경기도 군포시 당정동 543번지

⑱대리인 변리사 황 의 만

반도체 칩(chip)의 픽업(pick-up)장치

①실용신안 등록청구의 범위

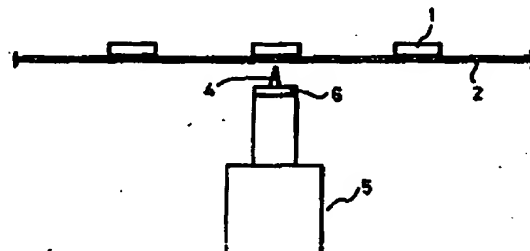
1. 작업다이(도시하지 않음)상에 별도의 이송장치에 의해 이송공급되며, 소정간격으로 칩(1)이 안치, 정착된 필름 테이프(2)의 상, 하부에 각각 흡착기(3)와, 이젝트 핀(4)이 구비된 이젝트부(5)를 구성하되, 상기 이젝트부(5) 상단부에 가열판(6)을 구성하여서 필름 특징으로한 반도체 칩(chip)의 픽업(pick-up)장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

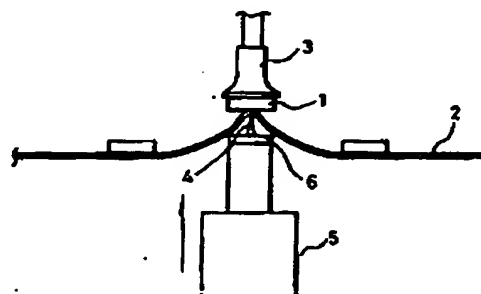
도면의 간단한 설명

제1도는 본 고안의 실시상태전의 설명도, 제2도는 본 고안의 실시 상태도.

제 1 도



제 2 도



Mailed Date: September 26, 2003  
Filing Due Date: November 26, 2003

NOTIFICATION FOR FILING OPINION

Applicant: name: Kabushiki Kaisha Toshiba

Application No.: 10-2001-46904

Title of Invention: MANUFACTURING METHOD OF A CHIP OF A PICKUP  
DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE

As the result of examination of the present application, the following reasons for rejection have been found and notified herein under Section 63 of the Patent Law. Any opinion about the rejection [Form 25-2 attached to the Regulations under the Patent Law] or any amendment [Form 5 attached to the Regulations under the Patent Law] must be filed by the above date. (The above date is extensible by one month for each request. No notification of allowing extension of time will be issued.)

[Reason]

The matter described in the claims of the present application is unpatentable because it does not fulfill the requirements under the provision of Section 42 (4) of the Patent Law.

Regarding the invention described in claim 17 of the present application, in the technical field the invention belonged to before this application, a person skilled in the art can easily provide the invention using the references below. Therefore, the present invention is unpatentable under the provision of the main sentence of Section 29 (2) of the Patent Law.

[Remarks]

1. In claim 14 of the invention in the present application, "a manufacturing method of a semiconductor device characterized in that the device sticks and holds an underside of an adhesive side of an adhesive tape" is described. However, there is no such content in the detailed description of the invention. Therefore, it is not considered that claim 14 is not supported

by a detailed description (Section 42 (4) (i)).

2. Claim 17 of the present invention is related to a pickup device in which pickup of a chip is made easy by heating the adhesive tape which the chip is adhered to using a heating mechanism and decreasing the adhesion strength. The invention is characterized in that it comprises a pressure mechanism having backup holder and a pin holder, the heating mechanism structured to heat the adhesive tape, and a sticking transfer mechanism to stick and transfer the chip. On the other hand, the detailed description and Fig. 1 of Korean Patent Publication No. 94-10646 (published October 24, 1994, thereafter "the cited invention 1") disclose a pickup device in which the constituent features are a pushup stage (12) and a pushup pin (6a-6d) corresponding to a pressure mechanism of the present invention, and a collet (7) and carrier device (14) corresponding to the sticking transfer mechanism of the present invention. Korean Patent Publication No. 92-13705 (published July 27, 1992, thereafter "the cited invention 2") discloses a pickup device in which the constituent feature is a heating plate (6) corresponding to the heating mechanism of the present invention. The heating mechanism described in claim 17 of the present invention and the heating plate disclosed in the cited invention 2 are constituent features with the same purpose. It is difficult to judge the distinguishability of the advantage or the difficulty of the structure of the described contents. Thus, it is acknowledged that a person skilled in the art can easily perform the invention of claim 17 by combining the cited inventions 1 and 2 (Section 29

(2) of the Patent Law).

[Attachments]

1. Korean Patent Publication No. 94-10646
2. Korean Patent Publication No. 92-13705

0150421

21626

출력 일자: 2003/9/27

발송번호 : 9-5-2003-037161658

수신 : 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&amp;

발송일자 : 2003.09.26

장 특허법률사무소)

제출기일 : 2003.11.26

주성민 귀하

## 특허청 의견제출통지서



**출원인** 명칭 가루시끼가이샤 도시바 (출원인코드: 519980849672)  
주소 일본국 도쿄도 미나토구 시바우라 1쵸메 1방 1고

**대리인** 성명 주성민 외 1명  
주소 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)

**출원번호** 10-2001-0046904

**발명의 명칭** 칩 픽업 장치 및 반도체 장치의 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매월 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인 통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

이 출원의 특허청구범위 제17항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

### [아래]

1. 본원발명의 특허청구범위 제14항에는 "상기 정작 테이프에 있어서의 정작면의 이면측을 흡착하여 보유 지지하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 방법"이라고 기재되어 있으나 상세한 설명에는 이와 같은 내용의 기재가 없습니다. 따라서 특허청구범위 제14항은 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없습니다 (특허법 제42조제4항제1호).

2. 본원발명의 특허청구범위 제17항은 가열 기구를 이용하여 칩이 부착되어있는 정작 테이프를 가열하여 정작력을 저하시킴으로써 칩의 픽업을 용이하게 하는 픽업 장치에 관한 것으로서, 백업 홀더와 핀 홀더를 구비한 압박 기구, 정작 테이프를 가열하도록 구성된 가열 기구, 그리고 칩을 흡착하여 반송하도록 구성된 흡착 반송 기구를 구비하는 것을 구성의 특징으로 하고 있습니다. 한편 한국등록특허공보 제94-10646호(94.10.24.자 공고, 이하 "인용발명1"이라 한다)의 상세한 설명 및 제1도에는 본원발명의 압박 기구에 해당하는 푸시업스테이지(12) 및 푸시업핀(6a-6d), 그리고 본원발명의 흡착 반송 기구에 해당하는 콤빗(7) 및 캐리어장치(14)를 구성 요소로 하는 픽업장치가 기재되어 있으며, 한국공개실용신안공보 제92-13705호(92.07.27.자 공개, 이하 "인용발명2"이라 한다)에는 본원발명의 가열 기구에 해당하는 가열판(6)을 주요구성요소로 하는 픽업 장치가 공개되어 있습니다. 본원발명의 특허청구범위 제17항에 기재된 가열 기구는 상기 인용발명2의 가열판과 동일한 목적의 구성 요소이고 그 기재 내용 상 구성의 곤란성이나 효과의 현저성을 판단하기 곤란하므로, 본원발명의 특허청구범위 제17항은 동일 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상기 인용발명1과 인용발명2의 조합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다 (특허법 제29조제2항).

### [첨부]

- 첨부 1 한국등록특허공보 제94-10646호 사본 1부  
첨부 2 한국공개실용신안공보 제92-13705호 사본 1부 끝.

출력 일자: 2003/9/27

2003.09.26

특허청

심사4국

반도체1심사담당관실

심사관 송원선



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-5731 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터